

佑星興業有限公司
YOU XING ENTERPRISE CO.,LTD

桃園縣龜山鄉振興路1173-1號
No.1173-1, Jhensing Rd., Gueishan Township, Taoyuan County 333,
Taiwan (R.O.C.)

TEL: 03-350-3435 359-5328 FAX : 03-350-2549

產品物性規範表

產品品名：AC-800-8A(Cu)DS1-M-200C
貼合面：離型紙
基材：0.025銅箔
說明：熱傳導效果佳
用途：適用於電腦及附屬週邊產品散熱用
如應用領域：高溫度晶片CPU
尺寸：650m/m*55M
銅-導熱係數(K): >400 W/m.K
膠-導熱係數(K): >6 W/m.K

操作環境：溫度:18°C~25°C，濕度:55%±10%

物性規範：

總厚度： 0.08mm
上膠厚度： 0.055mm (相變化膠)

軟化點：48°C

運用溫度-30~200度

備註：

- (1)試驗溫度23±5°C及溼度55%RH±10%RH
- (2)保存環境為20°C~30°C，避免放置溼度過高的地方
- (3)保存期限一年
- (4)以上數據僅供參考，實際情況須依客戶測試後效果為準

核準：黃振亮 審查：林書淵 製表人：蔡佳容 (105.12.19)